

股票简称：德福科技

股票代码：301511



九江德福科技股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年七月

九江德福科技股份有限公司拟向特定对象发行 A 股股票，公司编制了《九江德福科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《九江德福科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

本次发行计划募集资金总额不超过人民币 280,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	5 万吨人工智能高端电子电路 AI 铜箔项目	225,000.00	198,000.00
2	补充流动资金	82,000.00	82,000.00
	合计	307,000.00	280,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进度情况以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急和实际投入金额等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）5 万吨人工智能高端电子电路 AI 铜箔项目

1、项目概况

5 万吨人工智能高端电子电路 AI 铜箔项目投资总额 225,000.00 万元，拟使用募集资金投入金额 198,000.00 万元，拟由公司全资子公司琥珀新材实施，项目地位于江西省九江经济技术开发区。

本项目为建设高端电子电路 AI 铜箔生产线及配套设施，项目完全达产后可

实现年产高端电子电路铜箔 5 万吨生产能力。本项目紧密围绕公司主营业务开展，核心产品包括 FPC 用铜箔、RTF、HVLP、载体铜箔等高端电子电路铜箔产品，下游可应用于 AI 服务器、高速交换机、光模块、先进封装、消费电子、汽车电子、通讯雷达等领域。

2、项目建设的必要性

(1) 填补市场结构性供需缺口，加速国产替代进程

2025 年，我国高端电子电路铜箔市场呈现需求快速增长、高端供给不足、国产替代加速的整体格局。随着 AI 服务器、高速交换机、高速数据中心、5G/6G 通信设备、先进封装等下游应用放量，市场对于 RTF、HVLP 及载体铜箔等高端产品的需求显著提升。而市场供应方面，受限于产品技术壁垒、客户认证周期、高端产能释放周期等因素，呈现明显的高端产品结构性短缺，同时如 HVLP3 及以上等高阶产品供给仍主要依赖于进口，国产化率较低。

本项目聚焦高端电子电路铜箔的产能建设，核心产品契合下游人工智能产业发展趋势，新增产能将填补高端产品市场供给缺口，并加速国产替代进程，有利于保障国内产业链安全。

(2) 贯彻双轮驱动战略，进一步提升行业地位

公司坚持“锂电铜箔+电子电路铜箔”双轮驱动发展战略，经过多年经营发展，目前已成为全球锂电铜箔领域的绝对领先企业，在产能规模、前沿产品与技术及头部客户体系等方面均具有显著竞争优势。在电子电路铜箔领域，公司近年来持续深化“高频高速、超薄化、功能化”技术战略，已实现多项关键突破，包括高端产品开发和迭代、技术工艺创新和突破、高阶产品量产销售、下游头部客户认证和导入等。

本项目是公司贯彻双轮驱动战略的坚定举措，本项目实施后，公司将增强在高端电子电路铜箔领域的量产能力，进一步提升全球行业地位。

(3) 提升高端产品规模化供应能力，增强核心竞争优势

PCB 产业链头部客户对于铜箔产品供应的稳定性和一致性，以及铜箔厂商的大规模供货保障能力具有较高要求。公司已与生益科技、台光电子、松下电子、

联茂电子、华正新材、欣益兴、深南电路、胜宏科技等下游知名覆铜板和 PCB 客户建立了良好的合作关系，RTF、HVLP 等高端产品在多家下游客户逐步完成认证和批量供货。本项目实施后，公司将更好地满足行业头部客户的高端产品规模化供货需求，提高供应链保障能力，加深与客户的关系。

同时，规模化生产对于提升资源利用效率、降低成本具有明显作用。本项目实施后，公司将在高端电子电路铜箔领域实现规模效应的显著提升，有利于公司提高成本竞争优势，在与国际厂商的竞争中充分发挥核心优势。

3、项目建设的可行性

(1) 项目符合国家产业政策鼓励方向

电子电路铜箔是电子信息产业的基础材料，根据电力传输与信号传输的不同性能要求，电子电路铜箔下游广泛应用于消费电子、汽车电子、通讯雷达以及 AI 服务器等电子信息行业。我国“十五五”规划纲要提出，推进电子信息全产业链创新，加快突破关键零部件、元器件和专用材料。《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》指出，强化关键核心技术攻关，提升重点产业链供应链韧性和安全水平；提升元器件、零部件等产品可靠性、安全性。本项目属于电子信息产业链上游基础材料的创新和国产化突破，有利于保障国内供应链安全，符合政策的鼓励方向，具有良好的外部环境。

(2) 丰富的技术积累和量产经验为项目实施提供坚实基础

公司在铜箔行业深耕四十余年，具有行业内领先的技术优势和丰富的规模化生产经验。公司设有珠峰实验室、夸父实验室和天工实验室三个研发平台，分别统筹负责锂电铜箔、电子电路铜箔和高端铜箔前沿技术的研发工作，研发团队的学术背景及实践经验在行业内处于领先水平。同时，公司经过多年研发积累和技术创新，已实现多项高端电子电路铜箔产品的开发和量产供货，高端产品出货占比快速提升。强大的研发团队、深厚的技术积淀、丰富的规模化生产经验，为本项目的顺利实施提供了坚实基础。

(3) 优质稳定的客户资源为项目实施提供有力支持

当前，全球人工智能基础设施建设爆发式增长，带动上游高端电子电路铜箔

产品供不应求。在此背景下，公司已与生益科技、台光电子、松下电子、联茂电子、华正新材、欣益兴、深南电路、胜宏科技等下游知名覆铜板和 PCB 客户建立了良好的合作关系，RTF、HVLP 等高端产品在多家下游客户逐步完成认证和批量供货。其中，公司 RTF3 和 RTF4 产品已通过多家头部覆铜板厂商认证并实现批量供货，可适配高速服务器、Mini LED 封装及 AI 加速卡等高端应用场景；HVLP1-4 系列产品已实现批量供货，主要应用于 AI 服务器、高速交换机及光模块领域；HVLP5 亦已完成样品认证，正稳步推进客户导入。

4、项目投资概况

本项目投资总额为 225,000.00 万元，构成如下：

序号	项目	投资金额（万元）	投资占比
1	固定资产投资	204,406.00	90.85%
1.1	工艺设备费	156,972.00	69.77%
1.2	建筑工程费	41,323.00	18.37%
1.3	工程建设其他费用	1,705.00	0.76%
1.4	预备费	400.00	0.18%
1.5	建设期利息	4,006.00	1.78%
2	铺底流动资金	20,594.00	9.15%
合计		225,000.00	100.00%

5、项目实施主体和地点

本项目拟由公司全资子公司琥珀新材实施，项目地位于江西省九江经济技术开发区。

6、项目经济效益

本项目完全达产后将实现年产高端电子电路铜箔 5 万吨生产能力，有效提升公司在 RTF、HVLP、载体铜箔等高端领域的规模化供应能力，进一步增强公司核心竞争力，预计可为公司带来可观的经济效益。

（二）补充流动资金

1、项目概况

公司拟将本次募集资金 82,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司业务发展的营运资金需求，提升资金使用效率和经营业绩。

2、项目的必要性

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司分别实现营业收入 653,132.36 万元、780,544.57 万元和 1,243,653.66 万元，随着经营规模不断扩大、营业收入持续增长，公司对流动资金的需求也相应增加，因此公司需要补充与业务经营规模相适配的流动资金。

同时，铜箔行业由于固定资产投资规模大、原材料价值高以及高端产品研发投入大等特点，属于资金密集型行业。公司经过多年经营发展，已经成为全行业技术领先和产能规模最大的企业之一，这也导致公司的资产负债率相对较高。截至 2025 年末，公司的资产负债率达到 72.76%，同时 2025 年公司的财务费用率达到 2.34%，压低了公司的经营业绩。

本次发行拟募集资金 28.00 亿元，将大幅增加公司净资本和优化公司资产负债结构，同时拟使用募集资金补充流动资金，从而缓解公司销售收入不断增长带来的营运资金需求，提升公司经营业绩。

3、项目的可行性

公司本次发行募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关要求，具有可行性。公司已根据相关规定形成了规范有效的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，确保本次发行的募集资金得到规范使用。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策和公司未来整体战略方向，具有良好的发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目

顺利实施后，公司将提升高端电子电路铜箔的规模化供应能力，从而进一步增强公司核心竞争力，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产与净资产规模将有所增加，有利于优化公司财务结构，增强公司抗风险能力，提升公司运营规模和经济效益，为公司后续业务的持续发展提供良好的保障。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

本次向特定对象发行 A 股股票是公司紧握行业发展机遇、进一步提升竞争优势、实现战略发展目标的重要举措。公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司未来整体战略方向，具有良好的发展前景和经济效益。本次发行有利于进一步促进公司主营业务的发展，巩固提升公司在行业中的优势地位，同时也将提升公司的资金实力，增强公司抗风险能力，为公司长期、稳定的可持续发展夯实基础。

综上，本次募集资金投资项目具有可行性、必要性，符合公司和全体股东的利益。

九江德福科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 6 日